ブラインドビアＦＰＣ

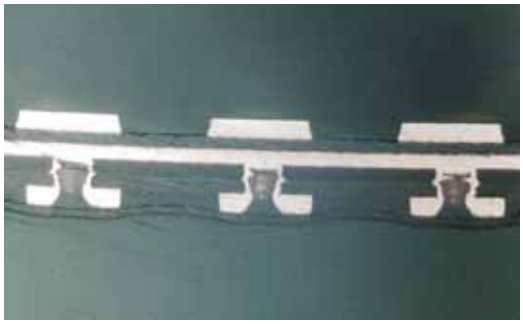
製品特徴

・ブラインドビアを使用した高密度配線の多層FPCを作成することが可能です。
・FPCの特性を活かした小型化・薄型化を実現致します。
・BGA・CSPのパッドの下に接続が可能です。

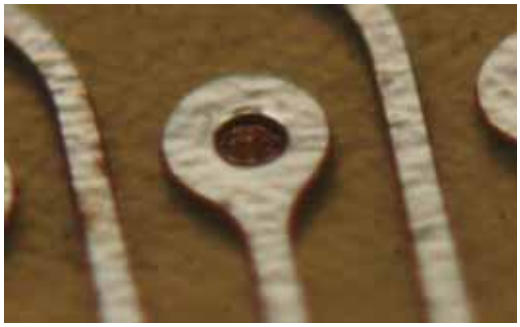
使用用途

・高密度配線用
・BGA・CSP搭載用

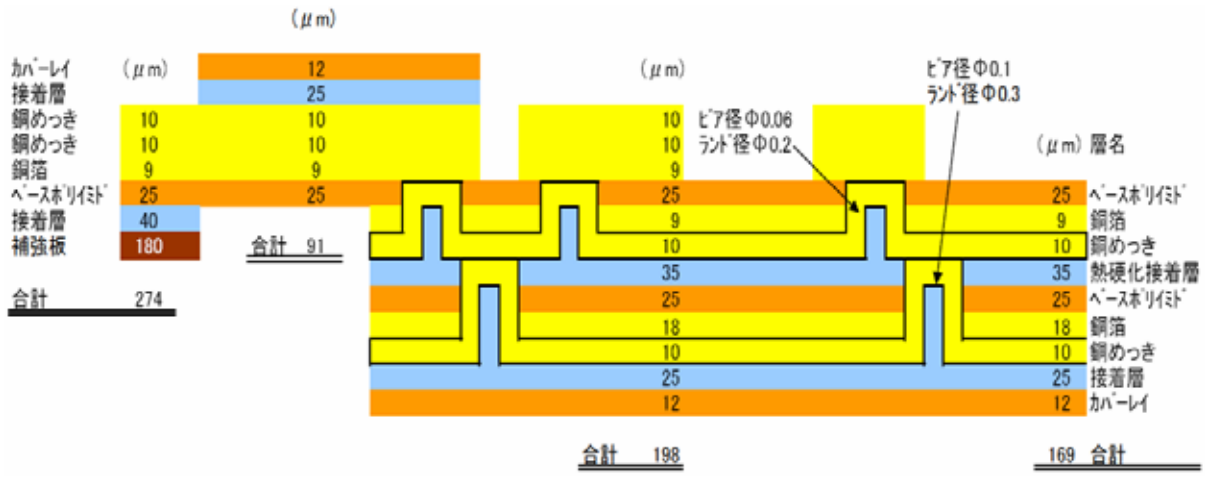
【断面写真】



【ビアの拡大写真】



製品構造



［お問合せ］ TEL.046-251-3722 FAX.046-251-3725
［ホームページ］ http://www.yamashita-net.co.jp
［E-mail ］ cc@yamashita-net.co.jp

YAMASHITA MATERIALS